

2024年3月期

第1四半期 決算説明

2023年8月3日

芝浦メカトロニクス株式会社

業績サマリー

■ 売上高・利益

- 対前年 増収増益
- 売上高は計画通りに推移し 143億円
SPE 前年比30%増収 (85億円 ⇒ 111億円)
- 営業利益は半導体前工程の売上増加などにより 21.3億円 (ROS 14.9%)
- 23/上 業績見通しは上振れ見込み

■ 受注高

- 半導体前・後工程とも堅調で 177億円
前年4Q比で半導体後工程が大幅に増加し 受注は堅調に推移

■ 持続的成長に向けた投資

- 研究開発新棟の建設投資実施 (2025年夏 竣工予定)

業績結果 (対前年)

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

(単位：億円)

	2022				2023 1Q	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	138	154	162	155	143	+3%
営業利益	21.2	24.8	37.2	25.9	21.3	+0.4%
ROS	15.3%	16.1%	23.0%	16.7%	14.9%	▲0.4pt
経常利益	19.1	23.5	35.2	27.3	22.1	+15%
当期純利益	16.8	17.4	27.2	30.6	17.9	+7%
受注高	289	185	114	179	177	▲39%

■ 売上高

前年比3%増収 (138億円 ⇒ 143億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は減少、全体として増収

■ 営業利益

前年比0.4%増益 (21.2億円 ⇒ 21.3億円)

- 半導体前工程の売上増加により増益

■ 経常利益

前年比15%増益 (19.1億円 ⇒ 22.1億円)

- 為替の影響により増益

■ 受注高

前年比39%減少 (289億円 ⇒ 177億円)

- 前年1Qが半導体前工程でまとまった受注があったため、全体として減少

セグメント別業績結果 (対前年) ①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比31%増 (85億円 ⇒ 112億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやウェーハ向けがいずれも順調で増加。
FPD前工程では、低調で減少。

➤ セグメント利益 前年比59%増 (13.5億円 ⇒ 21.5億円)

半導体前工程の売上増加により増益。

➤ 受注高 前年比47%減 (218億円 ⇒ 115億円)

半導体前工程では、前年1Qにウェーハ向けでまとまった受注があったため減少だが、全体として堅調に推移。

FPD前工程では、顧客の設備投資の影響を受け低調に推移。

セグメント別業績結果 (対前年) ②

■ メカトロニクスシステム部門

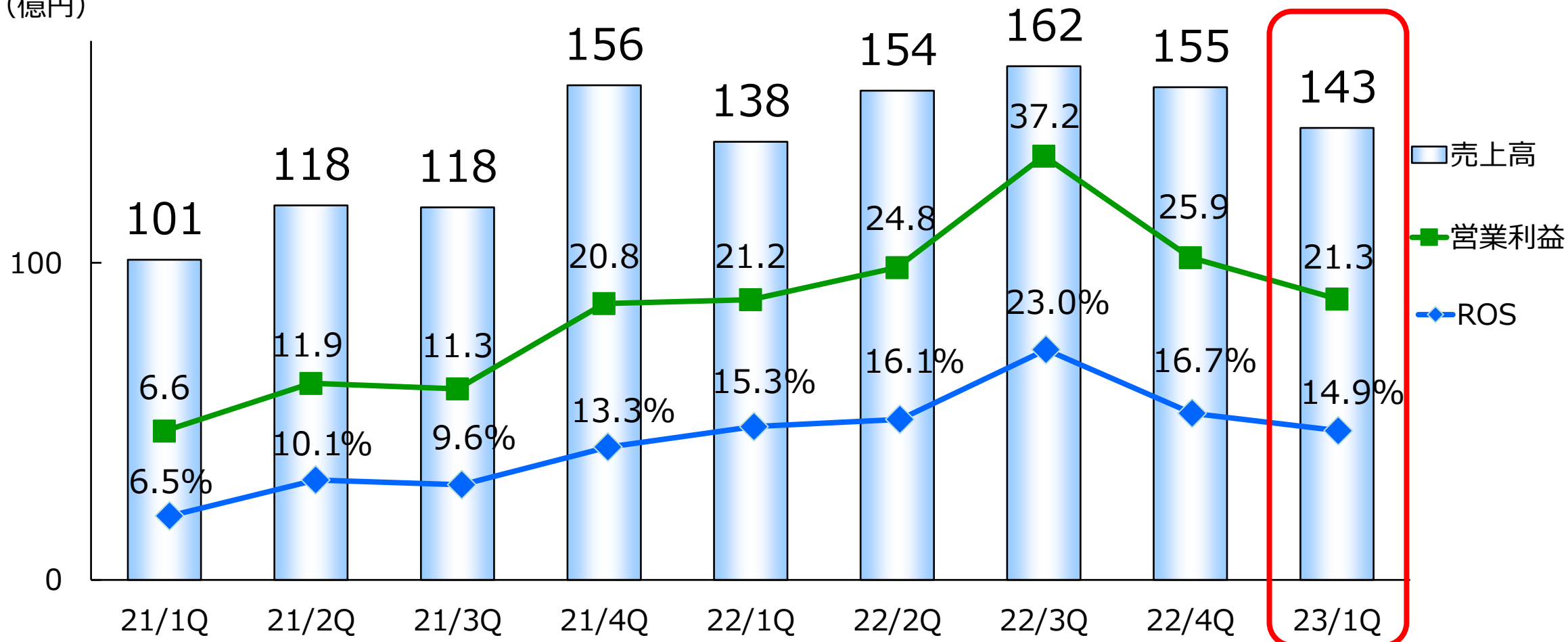
*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比52%減 (43億円 ⇒ 21億円)
半導体後工程では、全体として減少だが、先端パッケージ向けは堅調。
FPD後工程では、前年度受注低調の影響により減少。
真空部門では、半導体向けが堅調に推移したが、全体として減少。
- セグメント利益 前年比95%減 (7.6億円 ⇒ 0.4億円)
半導体後工程の売上減少が影響し減益。
- 受注高 前年比17%減 (61億円 ⇒ 50億円)
半導体後工程では、前年4Q比 大幅増で、生成AI用GPUの需要増に伴い
先端パッケージ向けが堅調に推移。
FPD後工程では、顧客の設備投資の影響を受け低調に推移。
真空部門では、半導体向けを中心に順調に推移。

売上高・利益・ROS

ROS14.9%

(億円)



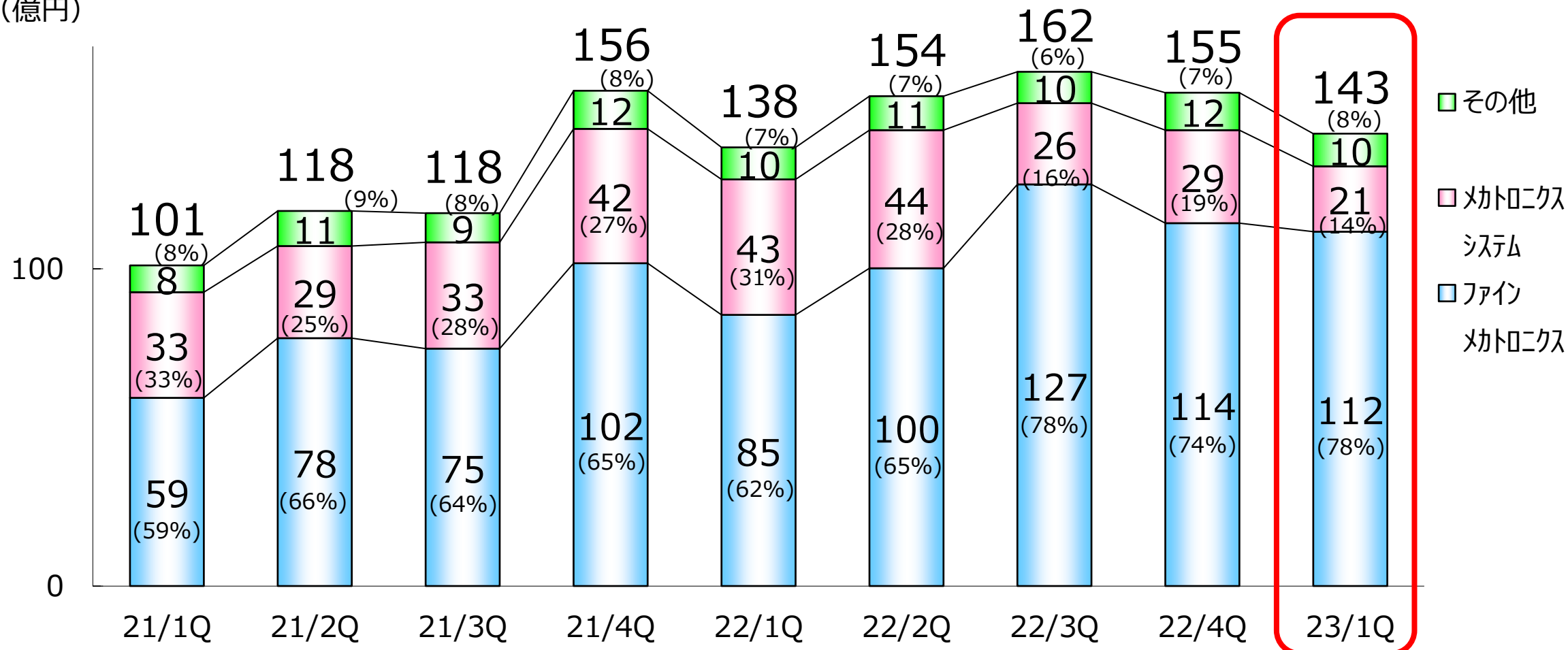
セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 78%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)

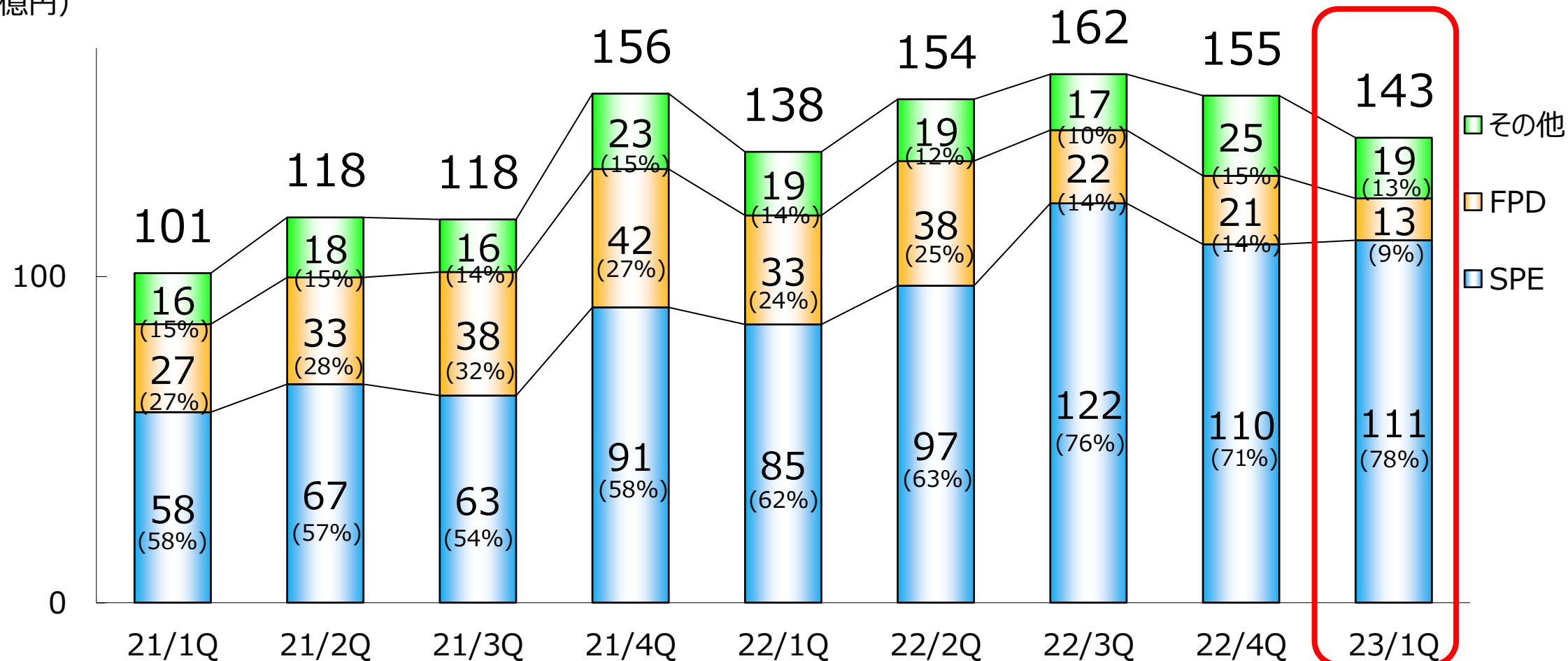


分野別売上高

SPE分野 78%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

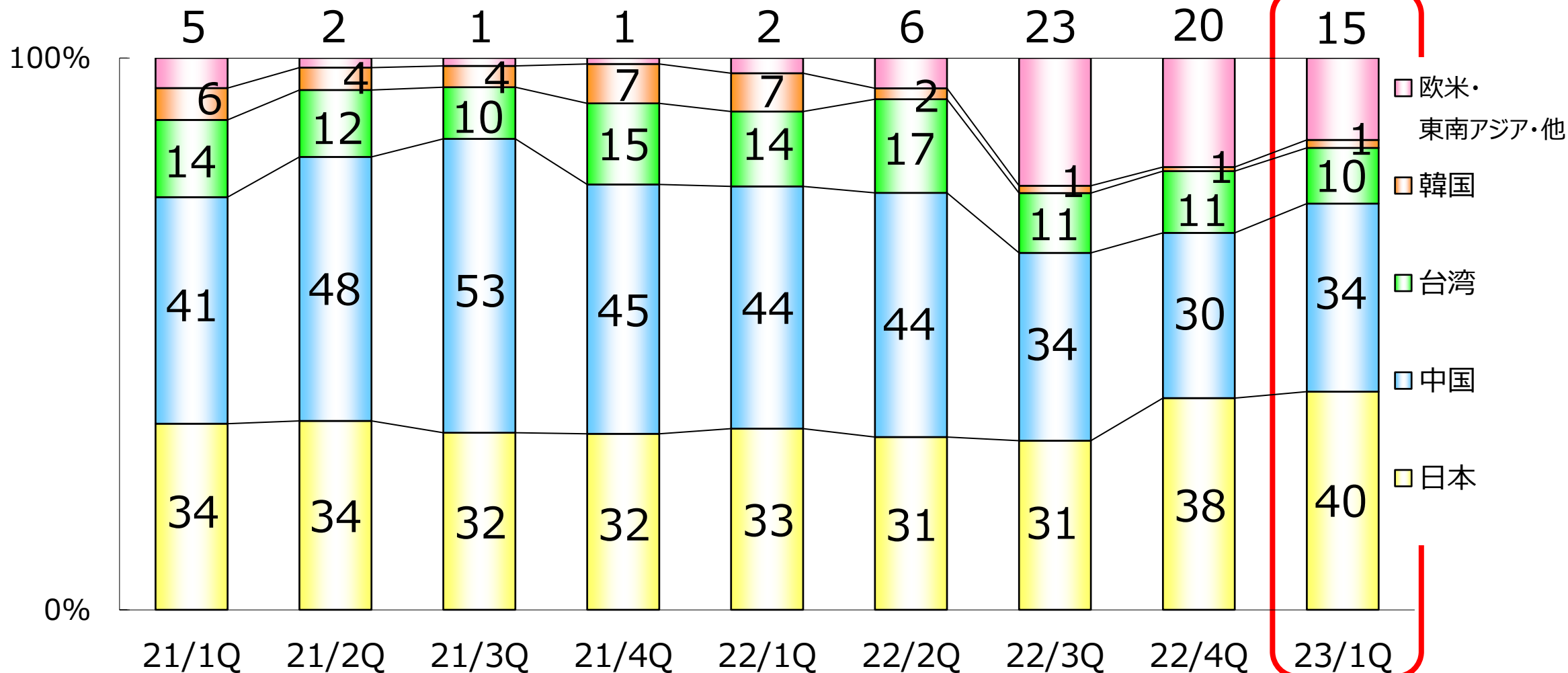
(億円)



地域別売上高比率

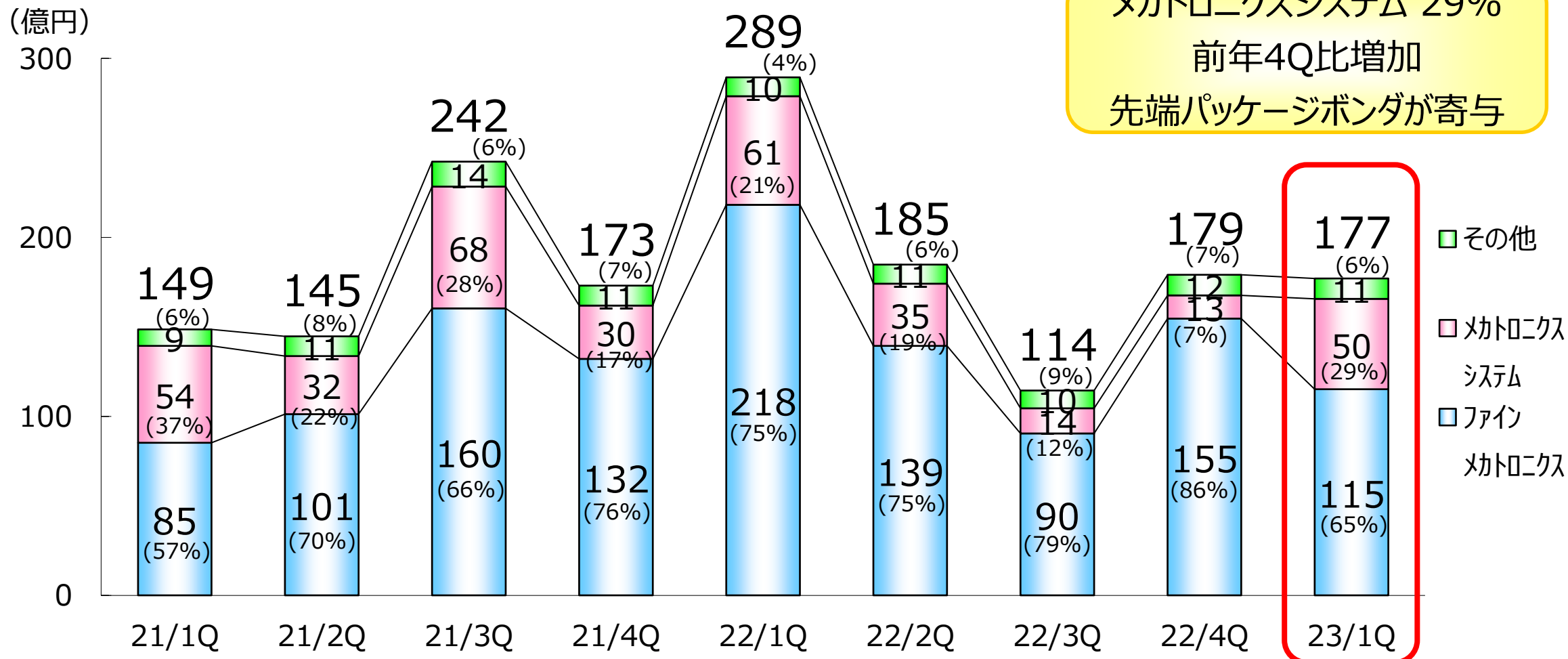
海外向け60% (中国34%)

* 仕向地で区分



セグメント別受注高

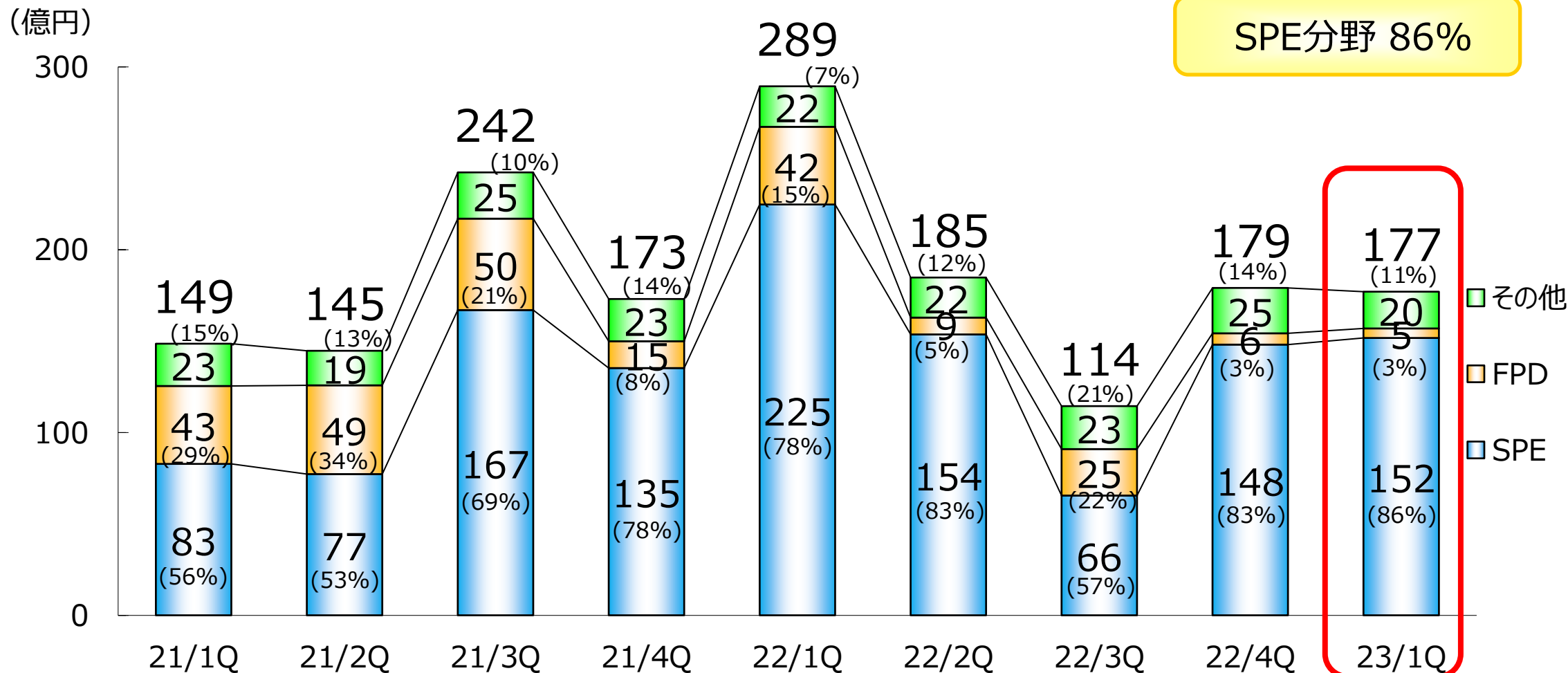
* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



メカトロニクスシステム 29%
前年4Q比増加
先端パッケージボンダが寄与

分野別受注高

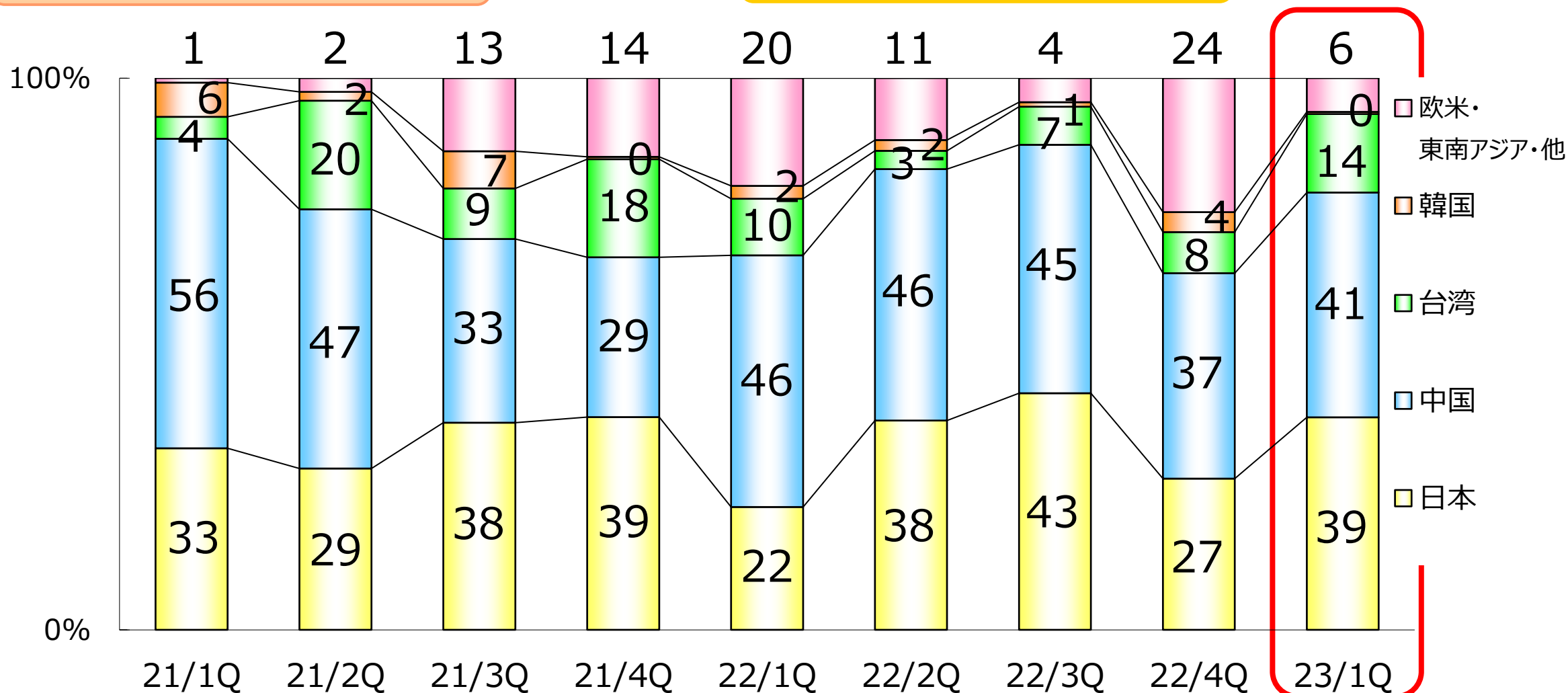
* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置



地域別受注高比率

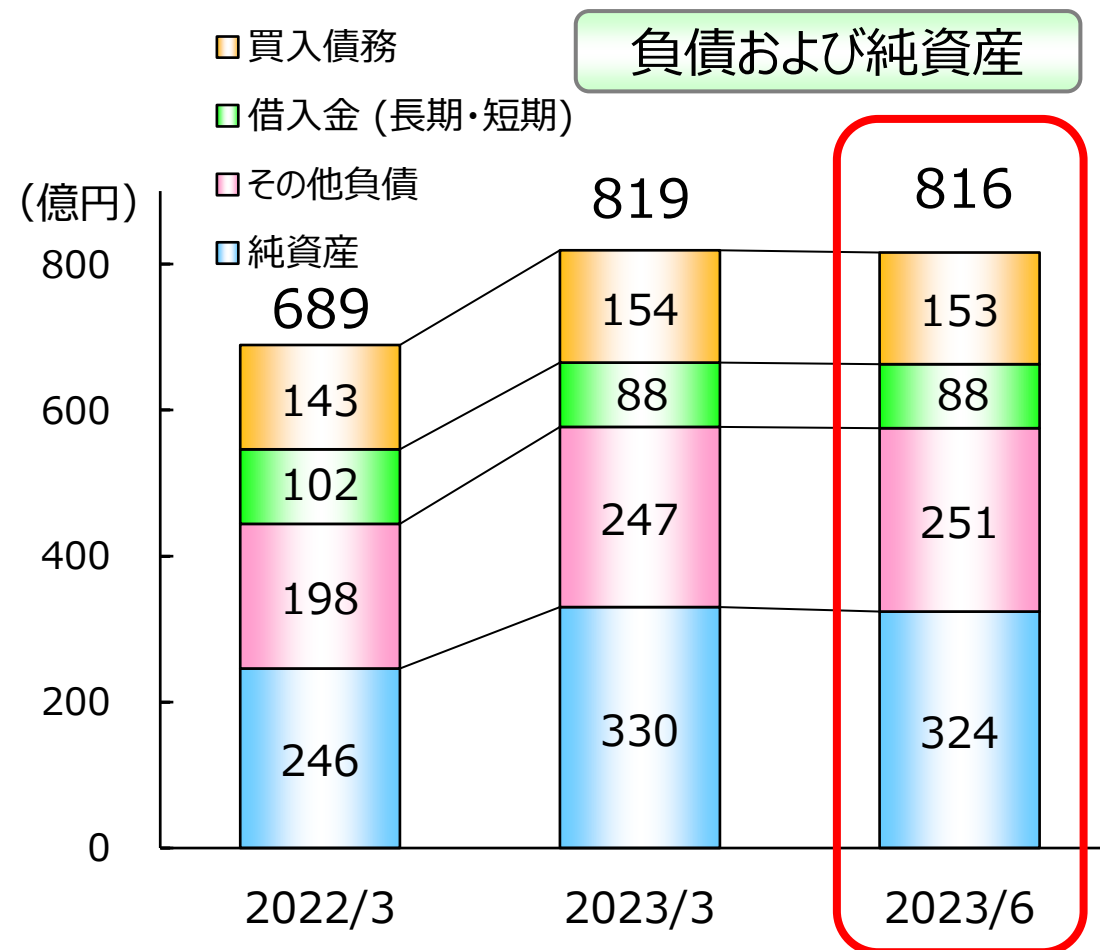
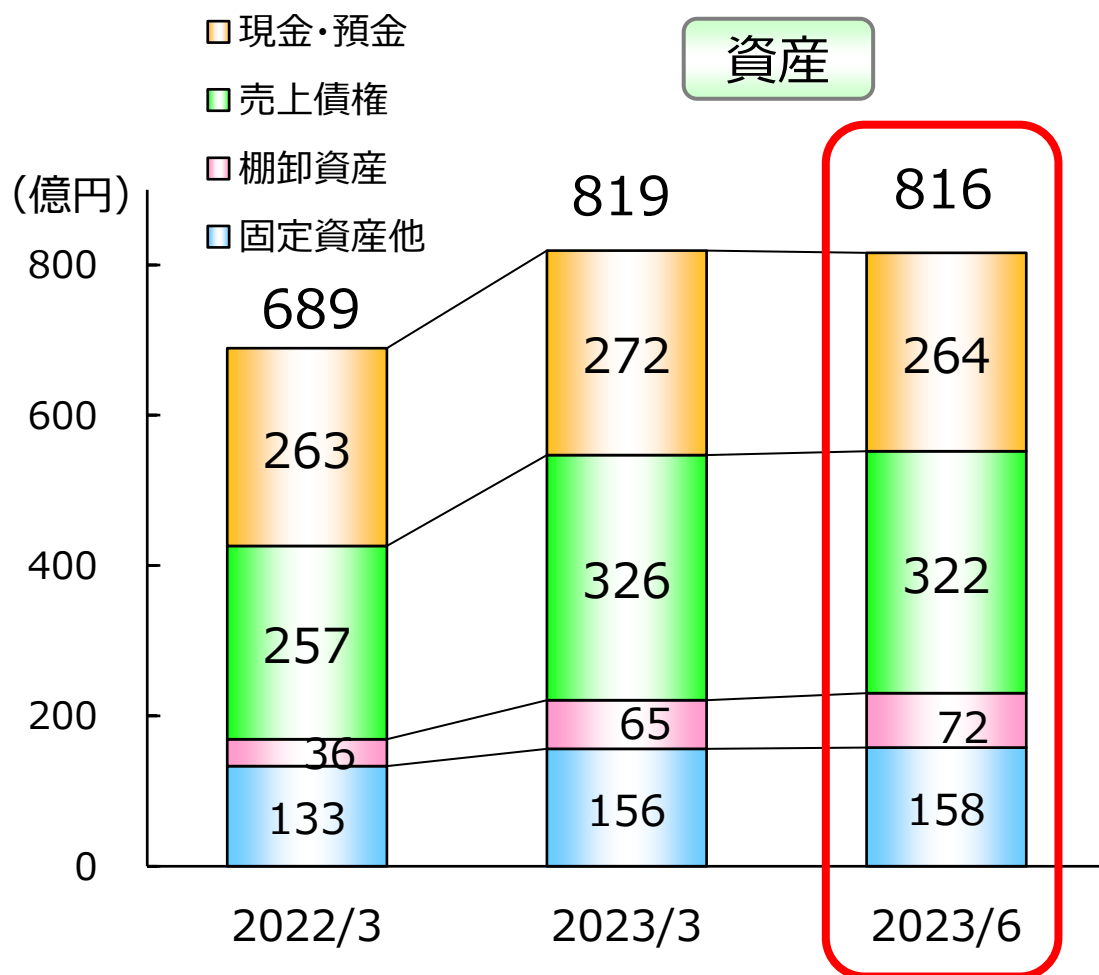
海外向け61% (中国41%)

* 仕向地で区分



貸借対照表

自己資本比率 40% ('23/3) → 40% ('23/6)
 D/Eレシオ 0.27倍 ('23/3) → 0.27倍 ('23/6)



2023年度 業績予想

業績予想

前回予想から通期業績予想変更なし、
上期見通しは上振れ見込み

*1: 2023年5月公表
23/上、23/下見通しはご参考
(単位: 億円)

	2020 年度	2021 年度	2022 年度			2023 年度 見通し		2023 年度 予想	前回予想 *1		2023 年度
			22/上	22/下	23/上 見通し	23/下 見通し	23/上 見通し		23/下 見通し		
売上高	448	493	293	317	610	290	300	590	260	330	590
営業利益	29.6	50.5	46.0	63.1	109.1	40.0	33.0	73.0	31.0	42.0	73.0
R O S	6.6%	10.3%	15.7%	19.9%	17.9%	13.8%	11.0%	12.4%	11.9%	12.7%	12.4%
経常利益	28.2	48.8	42.6	62.6	105.1	39.0	28.0	67.0	28.0	39.0	67.0
当期純利益	19.7	29.8	34.1	57.9	92.0	31.0	21.0	52.0	23.0	29.0	52.0
R O E	9.5%	12.8%	-	-	31.9%	-	-	15.0%	-	-	15.0%
F C F	74.1	77.9	43.8	-11.9	32.0	-	-	30.0	-	-	30.0

SPE

- グローバルニッチトップ対象製品群の売上堅調
SPE売上高 111億円の内、GNT 78億円（70%）で推移
- 新規顧客、新規工程の獲得により枚葉式リン酸エッチング装置が好調
- 先端パッケージボンダでは、生成AI用GPUの需要増に伴い受注増

* GNT：現中期経営計画
グローバル ニッチトップ
対象製品群



枚葉式リン酸エッチング装置
(SC300-HT Series)



先端パッケージボンダ
(TFC-6500)

FPD

- 前・後工程とも、依然として設備投資が低水準
- 車載向けパネルや大型OLEDパネルの需要増に期待

研究開発

持続的成長に向けた投資を実行中

■ 横浜事業所 研究開発新棟建設

- 半導体前工程向け製造装置の先端研究開発用クリーンルーム
- 3階建て、延床面積 約4,300m²
2025年夏 竣工予定

■ さがみ野事業所 クリーンルーム増設

- 半導体後工程向け製造装置の開発評価・試験用クリーンルーム
2024年春 竣工予定

■ 研究開発設備

設備投資は中計計画通り実行中



横浜事業所 研究開発新棟

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

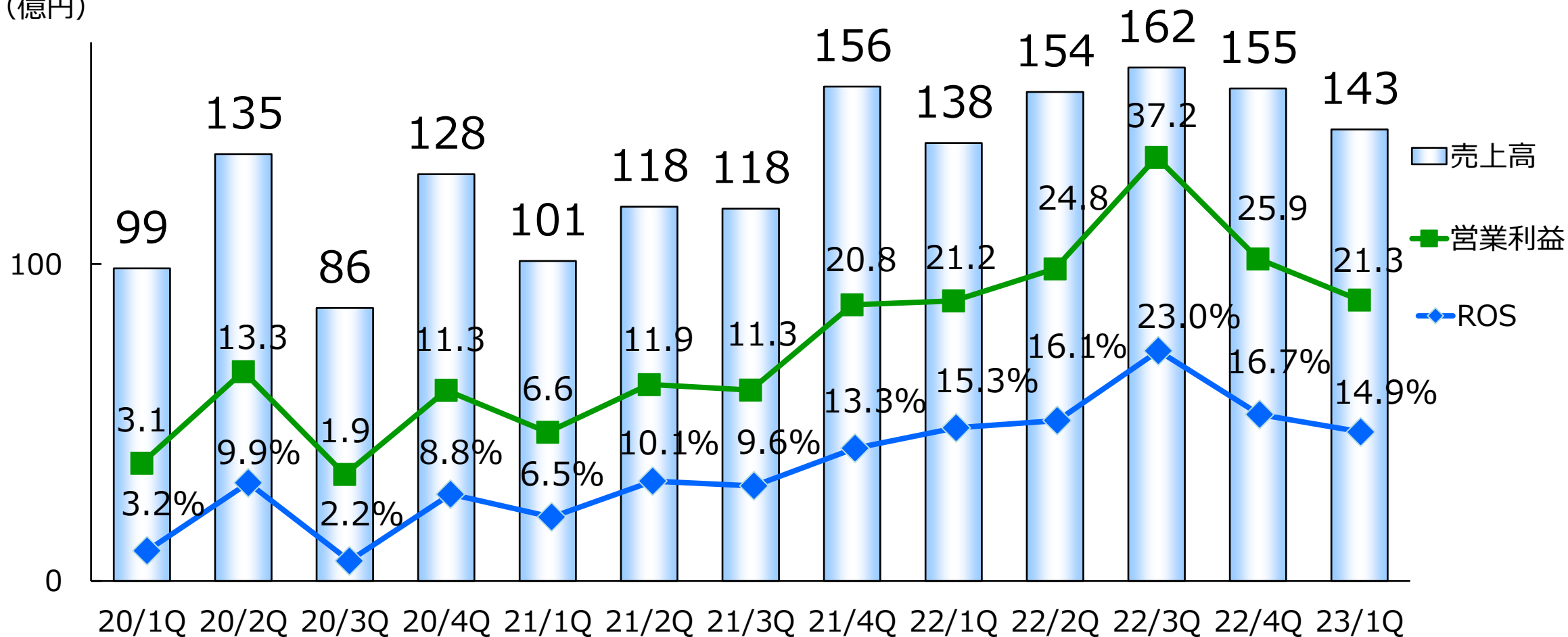
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END

Appendix

売上高・利益・ROS

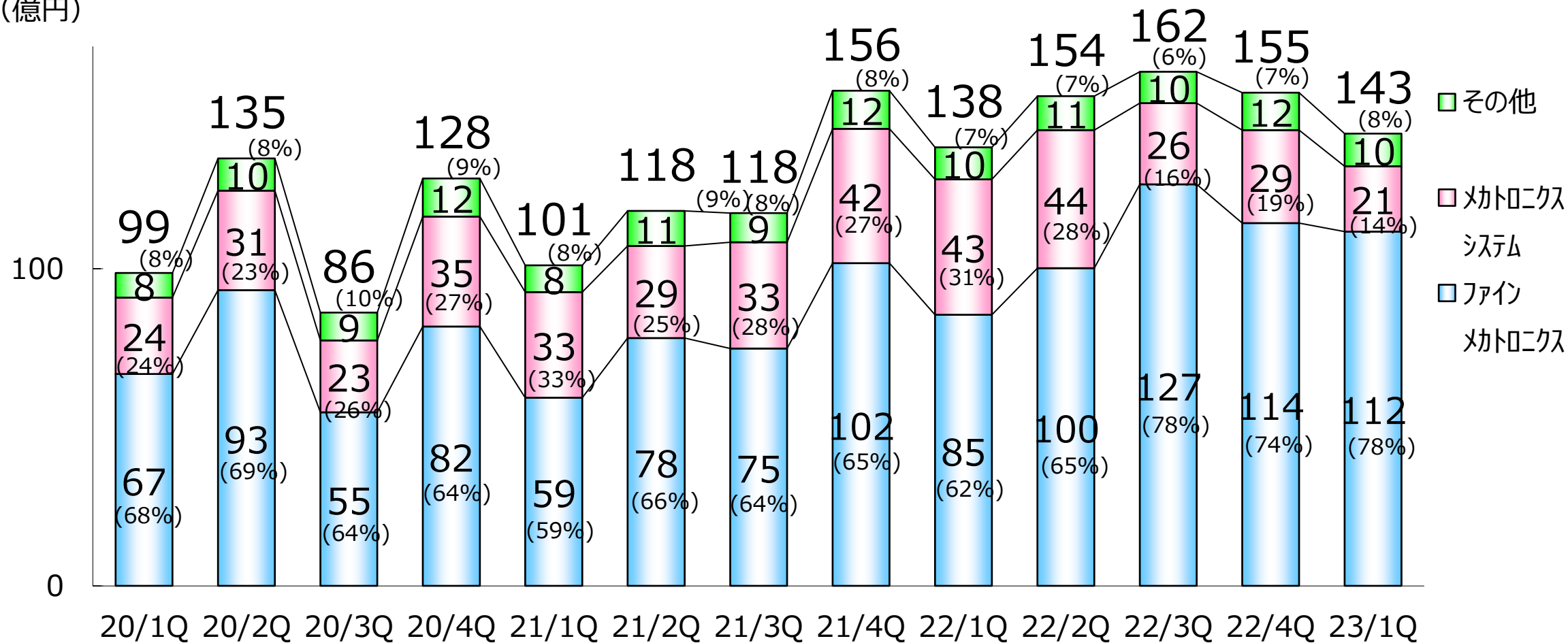
(億円)



セグメント別売上高

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

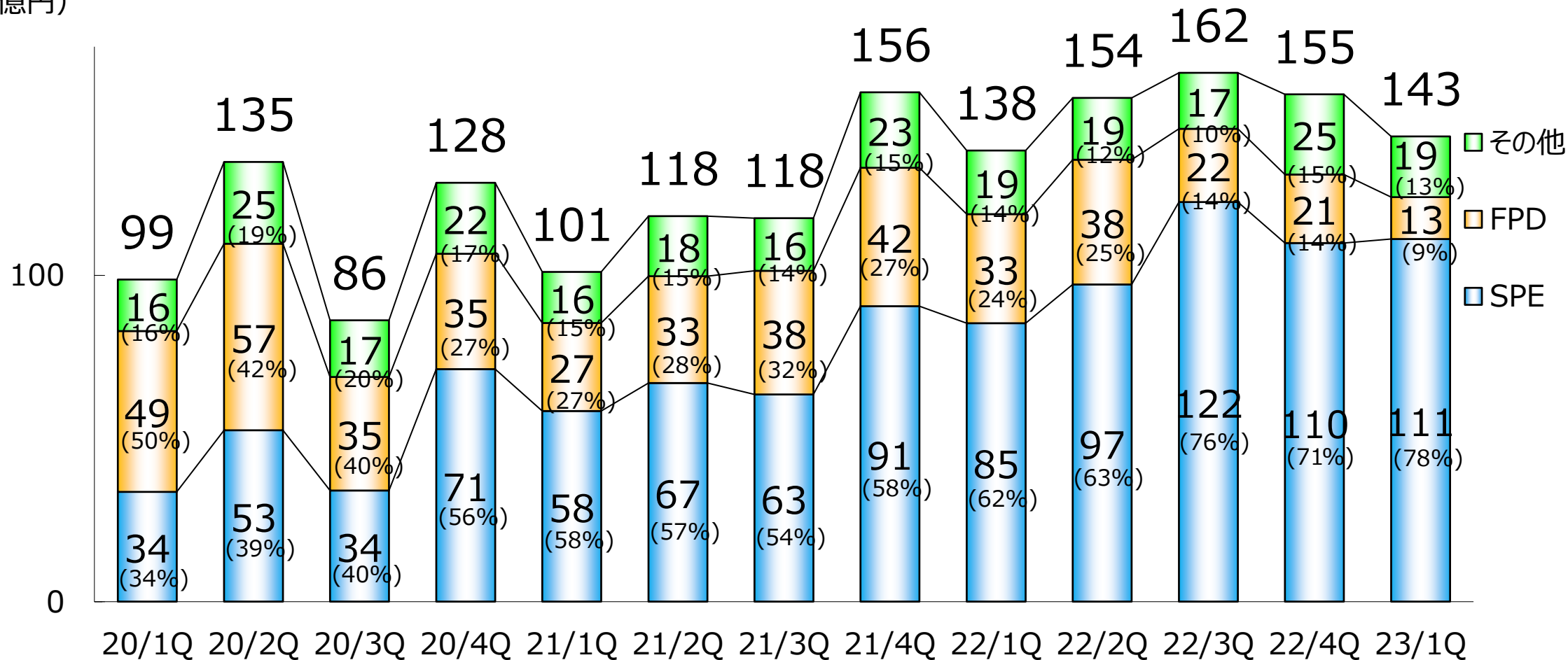
(億円)



分野別売上高

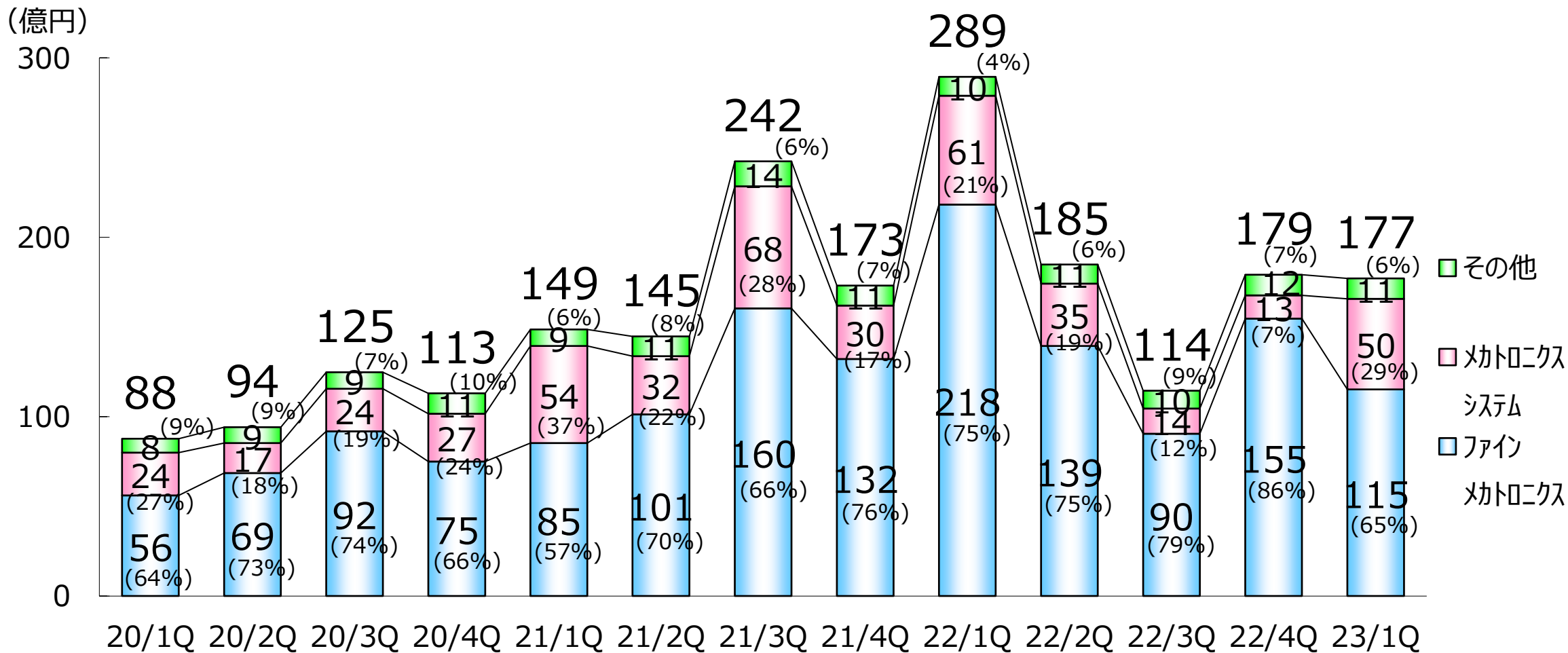
* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

(億円)



セグメント別受注高

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置
メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

